

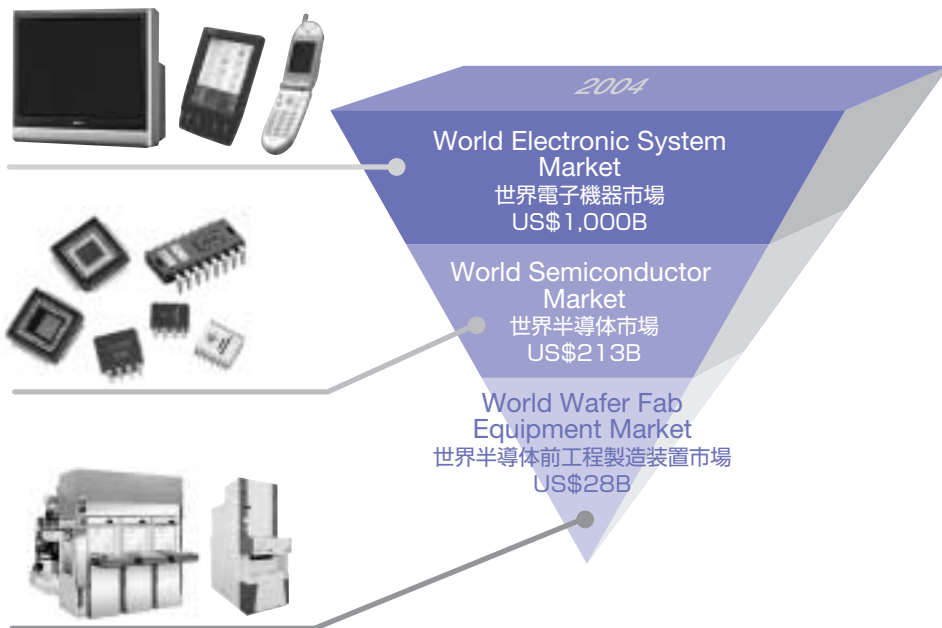
CONTENTS 目次

Industry Data	C2
インダストリー・データ	
Tokyo Electron (TEL) Overview	1
東京エレクトロン(TEL)の事業概要	
Global TEL	2
TELの世界展開	
Topics in Recent Years	3
近年のトピックス	
Semiconductor & TFT-LCD Manufacturing Process Flow	4
半導体製造工程及び TFT-LCD製造工程	
Consolidated Operating Results	6
連結業績	
Semiconductor Production Equipment (SPE) and FPD Production Equipment	8
半導体製造装置・FPD製造装置	
Consolidated Financial Data	10
連結財務データ	
Consolidated Balance Sheets	14
連結貸借対照表	
Consolidated Statements of Operations	16
連結損益計算書	
Consolidated Statements of Cash Flows	17
連結キャッシュ・フロー計算書	
Consolidated Quarterly Data	18
連結四半期データ	
Stock Information	20
株式情報	

TOKYO ELECTRON

2005 FACT BOOK

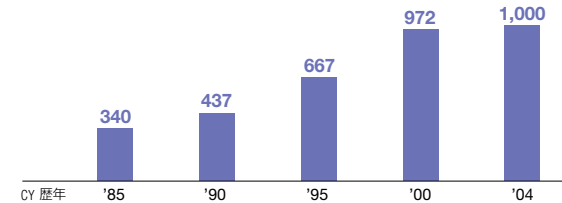
As of March 31, 2005



World Electronic System Market
世界電子機器市場

(US\$ Billion 十億ドル)

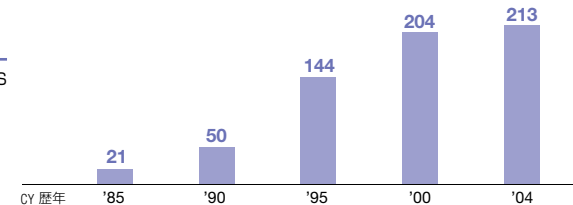
Source 出典: IC Insights



World Semiconductor Market
世界半導体市場

(US\$ Billion 十億ドル)

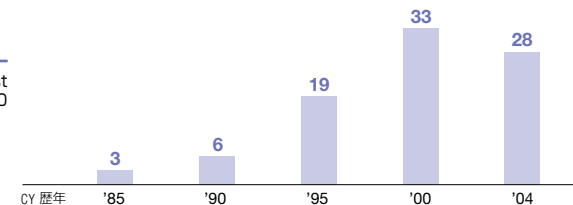
Source 出典: WSTS



World Wafer Fab Equipment Market
世界半導体前工程製造装置市場

(US\$ Billion 十億ドル)

Source 出典: Gartner Dataquest
(April 2005) GJ05190



World TOP 10 Semiconductor Production Equipment Manufacturers 半導体製造装置メーカー世界トップ10

CY 1990	
1	Tokyo Electron 東京エレクトロン
2	Nikon ニコン
3	Applied Materials アプライドマテリアルズ
4	Advantest アドバンテスト
5	Canon キヤノン
6	Hitachi 日立
7	General Signal ゼネラル シグナル
8	Varian バリアン
9	Teradyne テラダイン
10	Silicon Valley Group シリコンバレー グループ

CY 1995	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Canon キヤノン
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Advantest アドバンテスト
7	Hitachi 日立
8	Teradyne テラダイン
9	Dainippon Screen 大日本スクリーン
10	Varian バリアン

CY 2000	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Teradyne テラダイン
5	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィー
6	KLA-Tencor ケーエルイー・テンコール
7	Advantest アドバンテスト
8	Lam Research ラム・リサーチ
9	Canon キヤノン
10	Dainippon Screen 大日本スクリーン

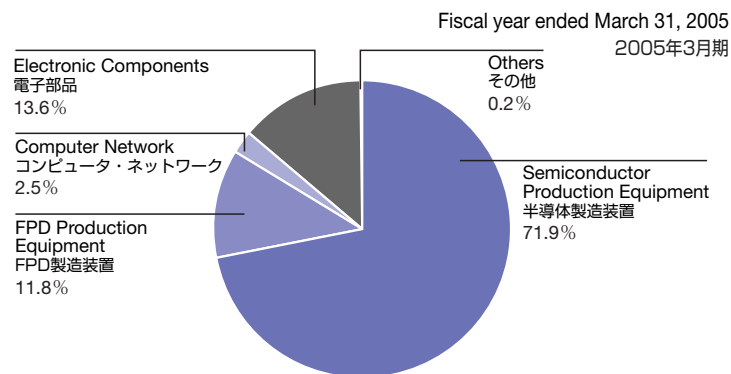
CY 2004	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィー
4	Advantest アドバンテスト
5	KLA-Tencor ケーエルイー・テンコール
6	Nikon ニコン
7	Lam Research ラム・リサーチ
8	Novellus Systems ノベラス システムズ
9	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ
10	Canon キヤノン

Source 出典: VLSI Research

■ Corporate Information
会社概要

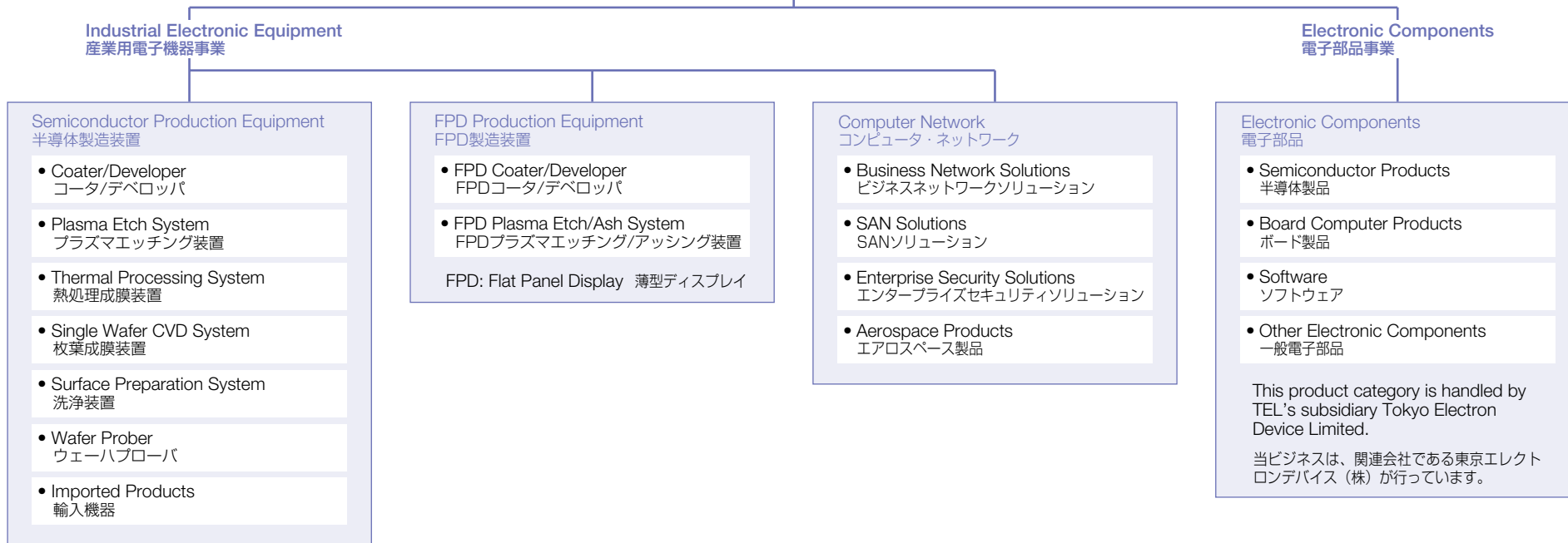
Corporate Name 商号	Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社
World Headquarters 本社所在地	TBS Broadcast Center, 3-6 Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 東京都港区赤坂5-3-6 TBS放送センター
Established 設立	November 11, 1963 1963年11月11日
Capital 資本金	¥54.9 Billion (as of March 31, 2005) 549億円 (2005年3月31日現在)

■ Composition of Net Sales by Division
部門別売上構成比



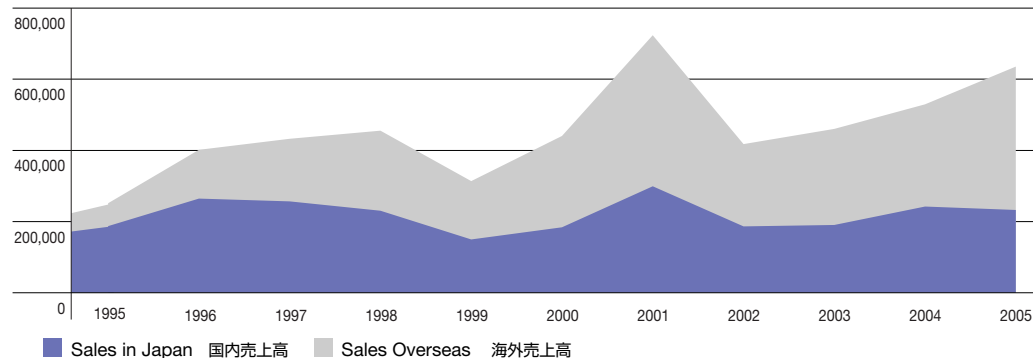
Major Products and Services
主要取扱製品

As of April 2005 (2005年4月現在)



Consolidated Sales in Japan and Overseas

連結国内・海外売上高推移

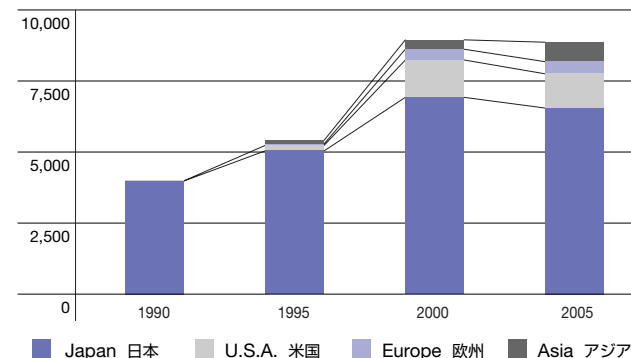


(¥ Millions 百万円)

FY 年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Sales in Japan 国内売上高	187,305	264,660	256,808	230,550	149,838	183,987	299,272	186,516	190,513	242,318	232,678
Sales overseas 海外売上高	64,378	137,115	175,977	225,035	163,982	256,742	424,608	231,309	270,067	287,336	403,032
Total 合計	251,683	401,775	432,785	455,585	313,820	440,729	723,880	417,825	460,580	529,654	635,710

Number of Employees Worldwide

ワールドワイド人員推移



(Persons 人)

FY 年度	1990	1995	2000	2005
Japan 日本	3,980	5,041	6,922	6,548
U.S.A. 米国	8	192	1,315	1,205
Europe 欧州	0	51	378	425
Asia アジア	0	126	331	686
Total 合計	3,988	5,410	8,946	8,864

Tokyo Electron Group 東京エレクトロングループ

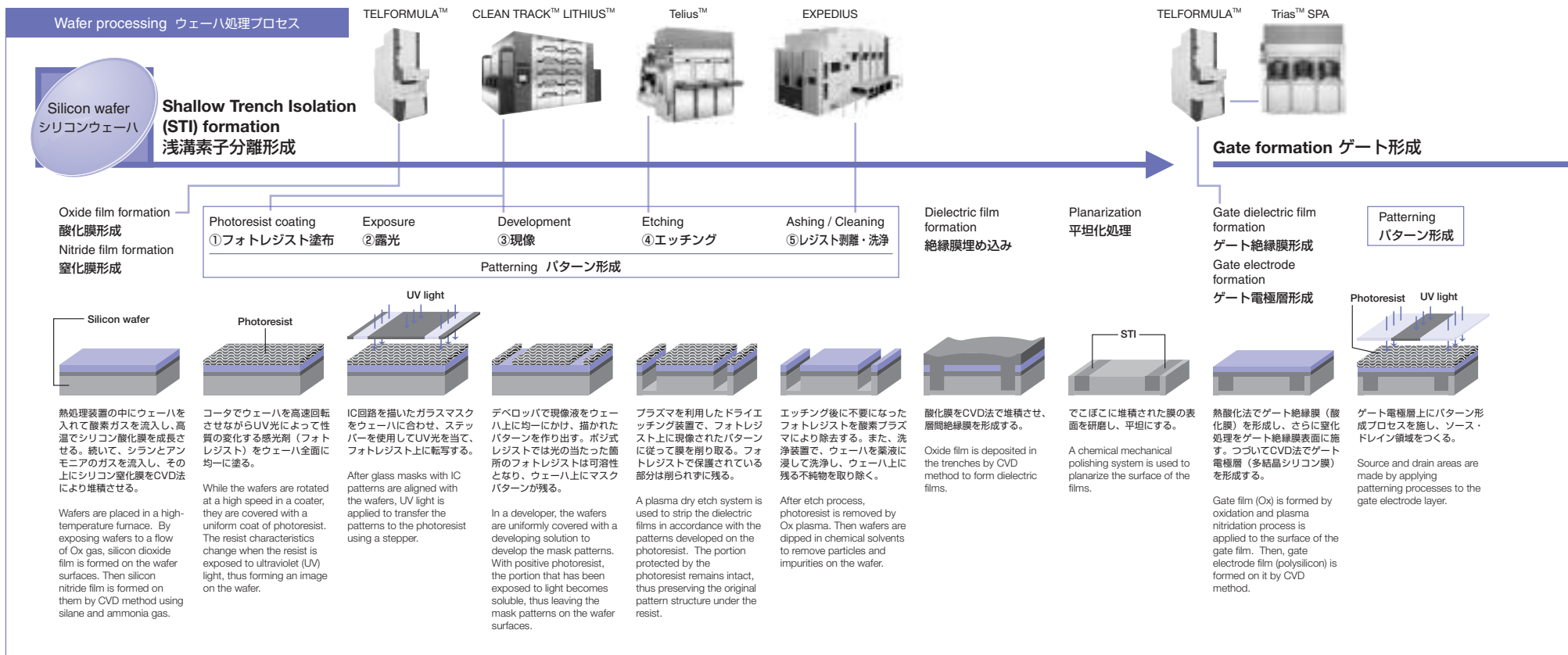
As of July 2005 (2005年7月現在)



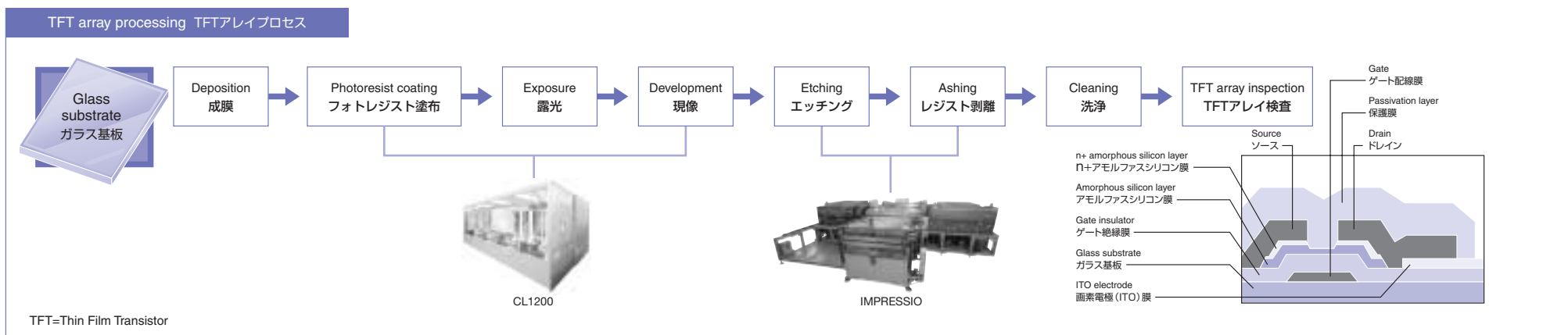
2000	2月 Feb	Shipments of CLEAN TRACK ACT8 coater/developer reached 1,000 units. コータ/デベロッパ「CLEAN TRACK ACT8」1,000台出荷達成
	8月 Aug	The trading unit for TEL stock changed from 1,000 shares to 100 shares. 1単位の株式数を1,000株から100株に変更
	8月 Aug	Shipment of Telius, a plasma etch system with a new platform, started. 新型プラットフォームを持つプラズマエッチングシステム Teliusの出荷を開始
	10月 Oct	TEL acquired Supercritical Systems, Inc. of the United States, a leader in supercritical cleaning and developing technology essential for 65nm technology and below. 65nm以降に有望な超臨界洗浄/現像技術を有する米国 Supercritical Systems, Inc.を買収し子会社にする
2001	2月 Feb	TEL acquired a stake in Timbre Technologies, Inc., a leader in advanced metrology software. 最先端の計測ソフトウェア技術を有する米国 Timbre Technologies, Inc.を買収し子会社にする
	10月 Oct	Shipment of SE-1200, a FPD plasma etch/ash system for 5th generation substrates, started. 第5世代基板対応 FPDプラズマエッチング/アッシング装置「SE-1200」の出荷を開始
	12月 Dec	Trias SPA, a new plasma process system, announced. 新製品 プラズマ処理装置「Trias SPA」を発表
	12月 Dec	Order accepting for TELFORMULA, a new high-speed thermal processing system capable of flexible loading, started. 新製品 フレキシブルロード対応高速熱処理成膜装置「TELFORMULA」の受注を開始
2002	4月 Apr	Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. established. 東京エレクトロン上海(株)を設立
	4月 Apr	Shipment of CL1200, a FPD coater/developer for 5th generation substrates, started. 第5世代基板対応 FPDコータ/デベロッパ「CL1200」の出荷を開始
	9月 Sep	e-BEAM Corp., a joint venture developing, manufacturing and marketing low energy electron beam direct writing systems for semiconductor production, established. 半導体製造用低加速電子ビーム直描装置に関する合弁会社(株)イービームを設立
	11月 Nov	TEL announced participation in Albany NanoTech project promoted by New York State. ニューヨーク州が推進する研究開発推進支援プログラム「オルバニー・ナノテック」プロジェクトへの参加を発表
2003	3月 Mar	Tokyo Electron Device Ltd. listed on the 2nd section of the Tokyo Stock Exchange. 東京エレクトロンデバイス(株)東京証券取引所第2部に上場
	6月 Jun	TEL received the Prime Minister's Award for its contribution to Industry-Academia-Government collaboration in connection with the development of Trias SPA plasma processing system. 大口径・高密度プラズマ処理装置「Trias SPA」の開発に対して産学官連携功労者表彰の内閣総理大臣賞を受賞
	8月 Aug	TEL Technology Center, America, LLC. (TTCA) established in the U.S. to conduct research and development of cutting-edge semiconductor materials and processes. 米国に先進的な半導体材料およびプロセスの研究を行う TEL Technology Center, America, LLC. (TTCA)を設立
2004	1月 Jan	TEL started volume production and shipment of CLEAN TRACK LITHIUS, a new coater/developer for 65nm node. 新製品65nmノード対応コータ/デベロッパ「CLEAN TRACK LITHIUS」の量産出荷を開始
	4月 Apr	Tokyo Electron AT Ltd. (surviving company) and Tokyo Electron Tohoku Ltd., manufacturing subsidiaries in Japan, merged. 国内製造拠点、東京エレクトロンAT(株)(存続会社)と東京エレクトロン東北(株)が合併
	7月 Jul	Tokyo Electron FE Ltd. (surviving company) and Tokyo Electron EE Ltd. merged. 東京エレクトロンFE(株)(存続会社)と東京エレクトロンEE(株)が合併
	7月 Jul	Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. established in the U.S., a holding company controlling U.S. subsidiaries: Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts, and TEL Technology Center, America. 米国に持株会社Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc.を設立。米国内現地法人Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts, TEL Technology Center, Americaを傘下に入れる
	7月 Jul	Order acceptance for EXPEDIUS, a high-performance auto wet station for 65nm node, started. 新製品65nmノード対応高性能バッチ式洗浄装置「EXPEDIUS」の受注を開始
2005	1月 Jan	TEL received Superior Corporate Disclosure Award from the Tokyo Stock Exchange for the second time following the award-winning in 1999. 東証より、1999年に引き続き2度目の「ディスクロージャー優良企業」に選定され、受賞

The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar. 半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程（ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス）は、ともによく似た工程です。

Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス



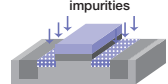
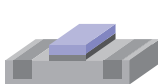
TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス



Interconnect formation (contact holes, via holes)
配線形成 (コンタクトホール・ビアホール)



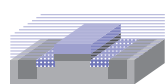
**Ion implantation
イオン注入
Annealing
アニール**



ソース・ドレイ領域にイオン注入法で導入した元素（ホウ素や砒素等）を打ち込む。酸化膜が残っている部分にはイオンが注入されない。その後、高温アニールによって不純物を均一に拡散させる。

An ion implanter dopes the source and drain areas with impurities, such as boron and arsenic. Ox films prevent dopant ions from being implanted in other areas. Subsequent annealing diffuses these impurities to a more uniform density.

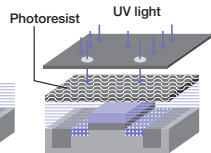
**Intermetal dielectric film formation
層間絶縁膜形成
Planarization
平坦化処理**



酸化膜をCVD法で堆積させ層間絶縁膜を形成し、表面を研磨して平坦にする。

Intermetal dielectric film is formed by oxide using CVD method and the film surface is planarized by polishing system subsequently.

**Patterning
パターン形成**



絶縁膜上にパターン形成プロセスを施し、コンタクトホールを開く。

Contact holes are opened by applying patterning processes to the dielectric film surface.

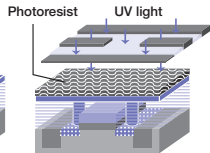
**Metal film formation
金属膜形成**



コンタクトホールにCVD法で金属膜を埋め込む。

Metal film is deposited in contact holes by CVD method.

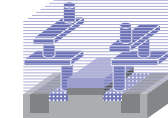
**Patterning
パターン形成**



金属膜上にパターン形成を施し、ビアを形成する。

Via is formed by patterning the metal film.

**Intermetal dielectric film formation
層間絶縁膜形成
Planarization
平坦化処理**

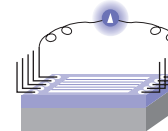


配線間を絶縁する低誘電率の膜を形成する。CVD装置や液体の材料をスピニングコートで塗布するSODコータを使う。

Low-dielectric-constant film is formed to insulate interconnects. CVD system or SOD coater that applies liquid materials through spinning is used.

**Wafer test
ウェーハ検査**

**Probe Testing
プローブ検査**



でき上がったウェーハには同じLSIチップが数百個作られている。プローブで1つ1つのチップにプローブ針を接触させ、つないだテストと信号のやりとりをしながらチップの良・不良を電気的に検査する。

There are several hundreds of identical LSI chips on a fabricated wafer. Prober makes pins contact chips, and tests whether chips are good or bad electrically by exchanging signals.

**Assembly process
組立プロセス**

**Inspection process
検査プロセス**

**Product
製品**

**Cell process
セルプロセス**

アレイ基板とカラーフィルター基板を貼り合わせ、その間に液晶を注入し、液晶セルを形成する。

An array substrate and a color filter substrate are bonded and liquid crystals are injected between them to form liquid crystal cells.

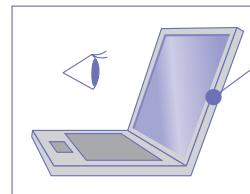
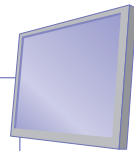
**Module process
組み立てプロセス**

ドライバICを実装し、金属やプラスチック製のフレームを取り付け、光源部分を組み立てて液晶モジュールが完成する。

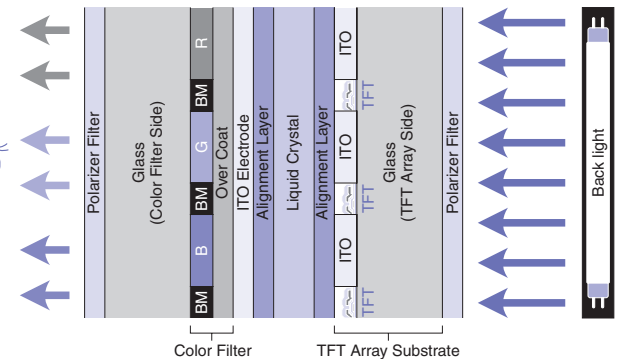
Liquid crystal display module is completed by mounting driver ICs on liquid crystal cells, fixing metal or plastic frame, and assembling back lights.

**Inspection process
検査プロセス**

**Product
製品**

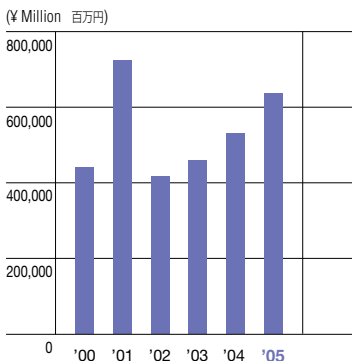


Side View of TFT-LCD panel

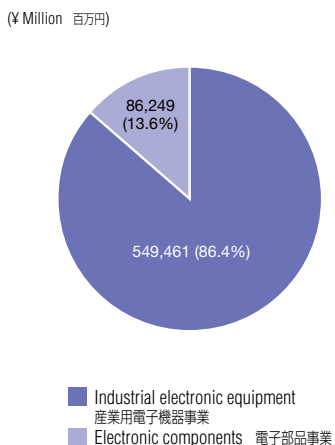


TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2005 is the fiscal year ended March 31, 2005. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2005は2005年3月31日に終了した会計年度です。

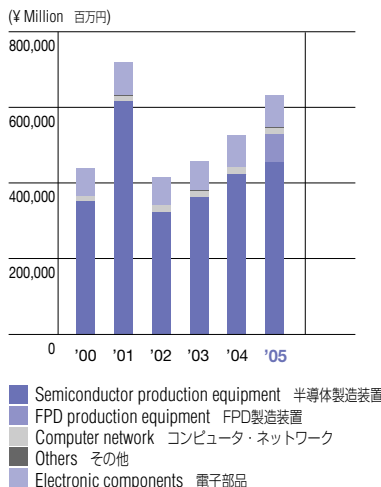
Net Sales
売上高



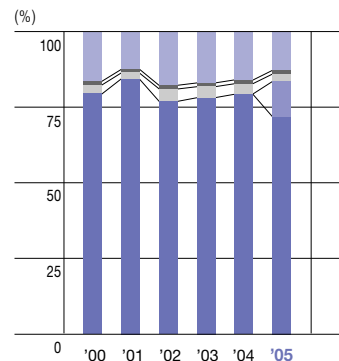
Net Sales by Business Segment in FY2005
2005年3月期事業セグメント別売上高



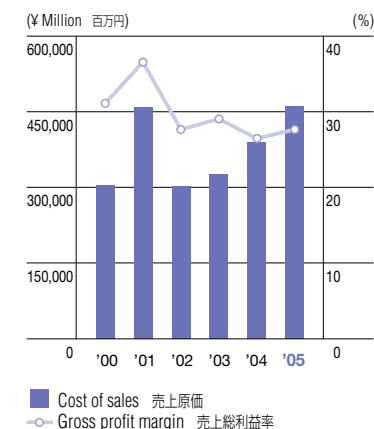
Net Sales by Division
部門別売上高



Composition of Net Sales by Division
部門別売上構成比



Cost of Sales and Gross Profit Margin
売上原価及び売上総利益率



FY 年度	Total 売上高合計	(% of total) 構成比	Industrial electronic equipment reclassified from FY2005 2005年3月期より産業用電子機器事業					FY 年度		
			Total of Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業	Semiconductor production equipment 半導体製造装置	FPD production equipment FPD製造装置	Computer network コンピュータ・ネットワーク	Other その他	Cost of sales 売上原価	Gross profit margin 売上総利益率 (%)	
2000	440,729	(100.0)	—	355,103 (80.6)	—	12,357 (2.8)	1,218 (0.3)	72,051 (16.3)	303,839	31.1
2001	723,880	(100.0)	—	619,001 (85.5)	—	14,054 (2.0)	1,614 (0.2)	89,211 (12.3)	458,902	36.6
2002	417,825	(100.0)	—	325,715 (78.0)	—	17,031 (4.1)	1,421 (0.3)	73,658 (17.6)	302,270	27.7
2003	460,580	(100.0)	—	364,689 (79.2)	—	17,193 (3.7)	1,318 (0.3)	77,380 (16.8)	326,540	29.1
2004	529,654	(100.0)	—	425,747 (80.4)	—	18,448 (3.5)	1,230 (0.2)	84,229 (15.9)	389,499	26.5
2005	635,710	(100.0)	549,461 (86.4)	457,191 (71.9)	75,038 (11.8)	15,966 (2.5)	1,266 (0.2)	86,249 (13.6)	459,797	27.7

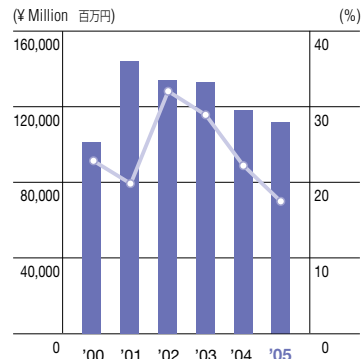
Segment sales are the sales to customers after eliminating inter-segment transactions. セグメント売上高は、セグメント間取引引去後の外部顧客に対する売上高です。

Notes: 1. From FY2005, the Company's business, which was classified as a single segment in previous years, is classified into two segments: "industrial electronic equipment" and "electronic components".
2. From FY2005, sales of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 1. 2005年3月期より、従来の単一セグメント区分から「産業用電子機器」「電子部品」の区分によるセグメントに変更しました。
2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高に含めていたFPD製造装置の売上高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

Selling, General and Administrative Expenses and Ratio to Net Sales

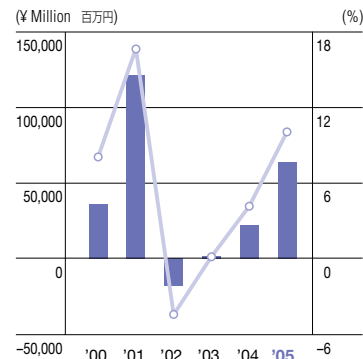
販売費及び一般管理費及び対売上高比率



■ SG&A expenses 販売費及び一般管理費
○ SG&A expenses ratio 販管費率

Operating Income (Loss) and Operating Margin

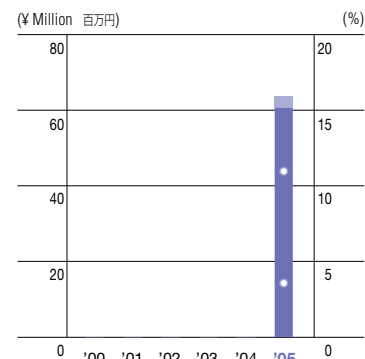
営業損益及び営業利益率



■ Operating income (loss) 営業損益
○ Operating margin 営業利益率

Operating Income and Operating Margin by Business Segment

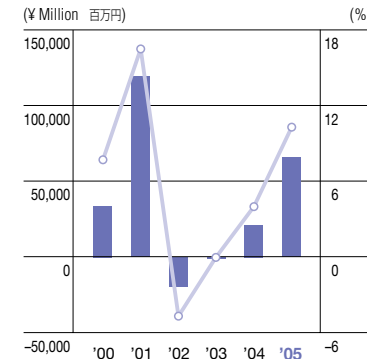
セグメント別営業利益・営業利益率



■ Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業
■ Electronic components 電子部品事業

Ordinary Income (Loss) and Ordinary Profit Margin

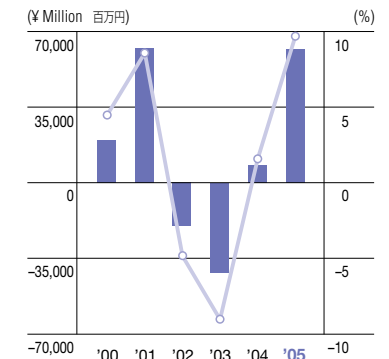
経常損益及び経常利益率



■ Ordinary income (loss) 経常損益
○ Ordinary profit margin 経常利益率

Net Income (Loss) and Net Income Margin

当期損益及び当期利益率



■ Net income (loss) 当期損益
○ Net income margin 当期利益率

FY	SG&A expenses	Ratio to net sales
年度	販売費及び一般管理費	対売上高比率 (%)
2000	101,074	23.0
2001	143,892	19.9
2002	133,865	32.1
2003	132,921	28.9
2004	117,875	22.3
2005	111,930	17.6

FY	Operating income (loss)	Operating margin
年度	営業損益	営業利益率 (%)
2000	35,816	8.1
2001	121,086	16.7
2002	(18,310)	(4.4)
2003	1,119	0.2
2004	22,280	4.2
2005	63,983	10.1

FY	Industrial electronic equipment		Electronic components	
	Operating income	Operating margin	Operating income	Operating margin
年度	営業利益	営業利益率 (%)	営業利益	営業利益率 (%)
2000	—	—	—	—
2001	—	—	—	—
2002	—	—	—	—
2003	—	—	—	—
2004	—	—	—	—
2005	60,791	11.0	3,107	3.5

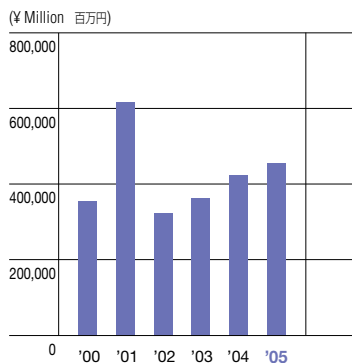
FY	Ordinary income (loss)	Ordinary profit margin
年度	経常損益	経常利益率 (%)
2000	33,838	7.7
2001	119,223	16.5
2002	(19,464)	(4.7)
2003	(230)	(0.0)
2004	21,167	4.0
2005	65,633	10.3

FY	Net income (loss)	Net income margin
年度	当期損益	当期利益率 (%)
2000	19,848	4.5
2001	62,012	8.6
2002	(19,938)	(4.8)
2003	(41,554)	(9.0)
2004	8,297	1.6
2005	61,601	9.7

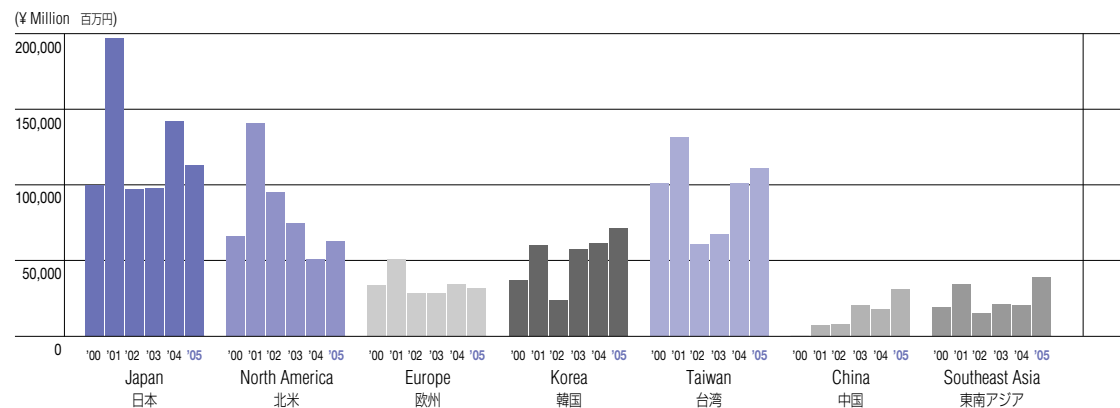
Notes: 1. From FY2005, the Company's business, which was classified as a single segment in previous years, is classified into two segments: "industrial electronic equipment" and "electronic components".
2. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 1. 2005年3月期より、従来の単一セグメント区分から「産業用電子機器」「電子部品」の区分によるセグメントに変更しました。
2. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関する費用を売上原価に変更しました。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

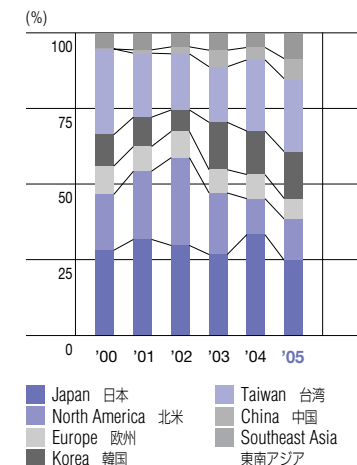
SPE Sales 半導体製造装置売上高



SPE Sales by Region 半導体製造装置地域別売上高



Composition of SPE Sales by Region 半導体製造装置地域別売上構成比

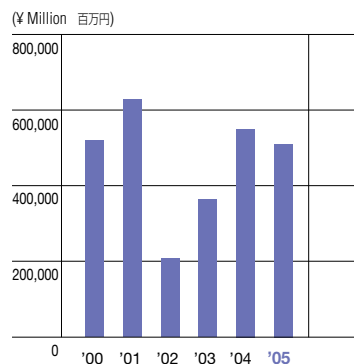


FY	(¥ Million)	FY	Japan (% of total)	North America	Europe	Korea	Taiwan	China	Southeast Asia	(¥ Million)	Total
年度	百万円	年度	日本 (構成比)	北米	欧州	韓国	台湾	中国	東南アジア	百万円	合計
2000	355,103	2000	99,650 (28.1)	65,537 (18.5)	33,559 (9.4)	36,826 (10.4)	100,961 (28.4)	—	18,570 (5.2)	355,103 (100.0)	
2001	619,001	2001	196,469 (31.7)	140,158 (22.6)	50,463 (8.2)	59,912 (9.7)	131,148 (21.2)	6,684 (1.1)	34,167 (5.5)	619,001 (100.0)	
2002	325,715	2002	96,724 (29.7)	94,733 (29.1)	28,319 (8.7)	23,196 (7.1)	60,474 (18.6)	7,494 (2.3)	14,775 (4.5)	325,715 (100.0)	
2003	364,689	2003	97,429 (26.7)	74,294 (20.4)	27,979 (7.7)	57,304 (15.7)	66,998 (18.4)	20,116 (5.5)	20,569 (5.6)	364,689 (100.0)	
2004	425,747	2004	141,916 (33.3)	50,622 (11.9)	33,896 (8.0)	61,412 (14.4)	100,455 (23.6)	17,558 (4.1)	19,888 (4.7)	425,747 (100.0)	
2005	457,191	2005	112,455 (24.6)	62,725 (13.7)	31,127 (6.8)	71,052 (15.5)	110,646 (24.2)	30,669 (6.7)	38,517 (8.5)	457,191 (100.0)	

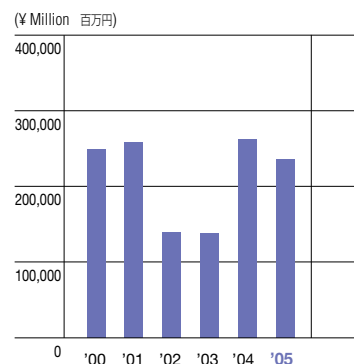
Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
 2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.
 3. Geographical sales are classified according to sales destinations.
 4. Sales in China for FY2000 are included in the sales in Southeast Asia.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を含めて表示しています。
 3. 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。
 4. 2000年3月期の中国向け売上は東南アジアに含めています。

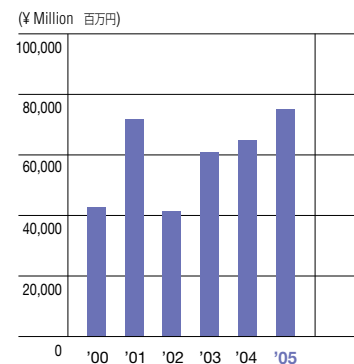
SPE Orders Received 半導体製造装置受注高



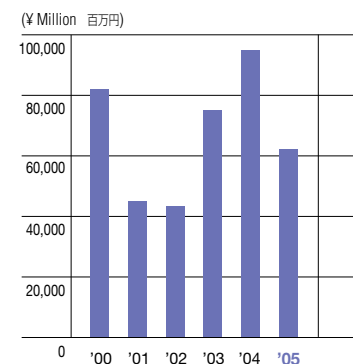
SPE Order Backlog 半導体製造装置受注残高



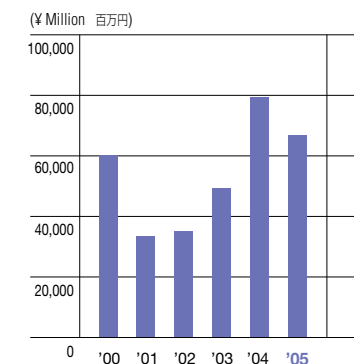
FPD Production Equipment Sales FPD製造装置売上高



FPD Production Equipment Orders Received FPD製造装置受注高



FPD Production Equipment Order Backlog FPD製造装置受注残高



FY	(¥ Million 百万円)
2000	520,472
2001	627,573
2002	207,189
2003	363,413
2004	549,774
2005	510,537

FY	(¥ Million 百万円)
2000	249,545
2001	258,117
2002	139,591
2003	138,314
2004	262,340
2005	236,179

FY	(¥ Million 百万円) Non-consolidated 単 独
2000	42,639
2001	71,779
2002	41,438
2003	61,100
2004	64,770
	Consolidated 連結
2005	75,038

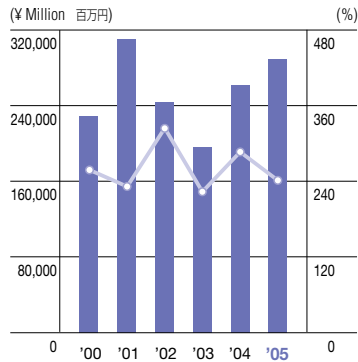
FY	(¥ Million 百万円) Non-consolidated 単 独
2000	81,869
2001	44,925
2002	43,322
2003	75,017
2004	95,030
	Consolidated 連結
2005	62,283

FY	(¥ Million 百万円) Non-consolidated 単 独
2000	60,285
2001	33,431
2002	35,315
2003	49,232
2004	79,493
	Consolidated 連結
2005	66,752

Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.

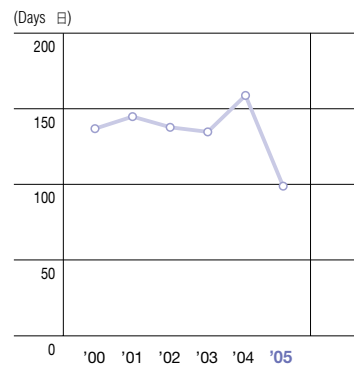
注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を含めて表示しています。

Working Capital and Current Ratio 運転資本及び流動比率



■ Working capital 運転資本
○ Current ratio 流動比率

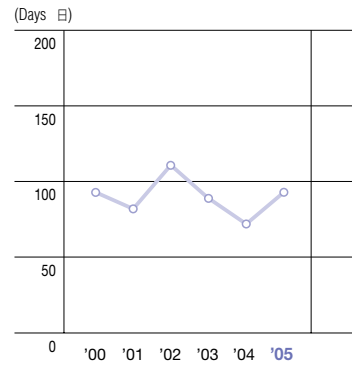
Receivable Turnover 売上債権回転日数



FY	Receivable turnover (Days)
2000	137
2001	145
2002	138
2003	135
2004	159
2005	99

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365
売上債権回転日数 = 期末受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 365

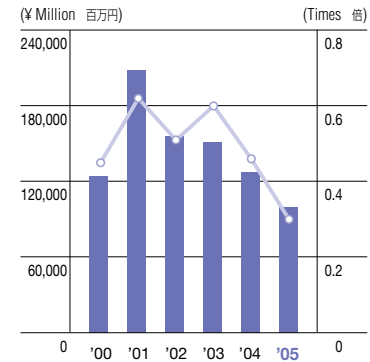
Inventory Turnover たな卸資産回転日数



FY	Inventory turnover (Days)
2000	93
2001	82
2002	111
2003	89
2004	72
2005	93

Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365
たな卸資産回転日数 = 期末たな卸資産 ÷ 売上高 × 365

Interest-Bearing Debt and Debt-to-Equity Ratio 有利子負債及びデット・エクイティ・レシオ

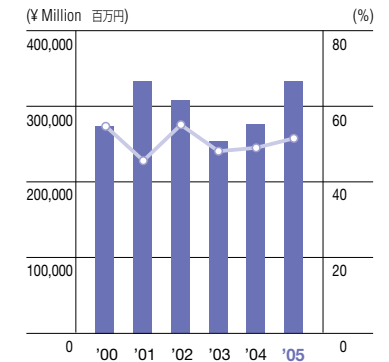


■ Interest-bearing debt 有利子負債
○ Debt-to-equity ratio デット・エクイティ・レシオ

FY	Interest-bearing debt (¥ Million)	Debt-to-equity ratio (Times)
2000	123,974	0.45
2001	207,780	0.62
2002	155,763	0.51
2003	151,362	0.60
2004	127,045	0.46
2005	99,451	0.30

Debt-to-equity ratio = Interest-bearing debt / Total shareholders' equity at fiscal year-end
デット・エクイティ・レシオ = 有利子負債 ÷ 期末株主資本 (倍)

Shareholders' Equity and Equity Ratio 株主資本及び株主資本比率



■ Shareholders' equity 株主資本
○ Equity ratio 株主資本比率

FY	Shareholders' equity (¥ Million)	Equity ratio (%)
2000	273,603	54.8
2001	333,281	45.7
2002	307,579	55.2
2003	252,904	48.2
2004	275,800	49.1
2005	332,165	51.6

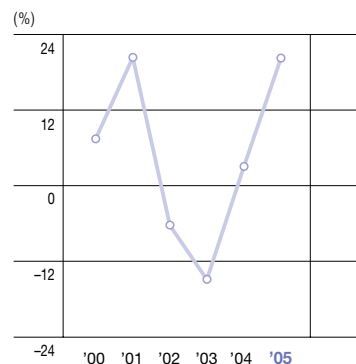
Working capital = Current assets – Current liabilities
運転資本 = 流動資産 – 流動負債
Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
2. The figure for trade notes and accounts receivable used for calculation of the receivable turnover does not include the figure for non-trade accounts receivable.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
2. 売上債権回転日数の計算の元になる「受取手形及び売掛金」の数字には未収金を含んでいません。

Return on Equity (ROE)

株主資本利益率

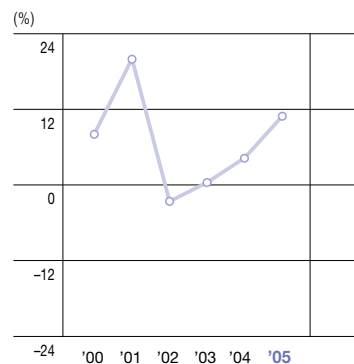


FY 年度	ROE (%) 株主資本利益率
2000	7.5
2001	20.4
2002	(6.2)
2003	(14.8)
2004	3.1
2005	20.3

ROE = (Net income / Average total shareholders' equity) × 100
株主資本利益率 = 当期利益 ÷ 期首・期末平均株主資本 × 100 (%)

Return on Assets (ROA)

総資産利益率

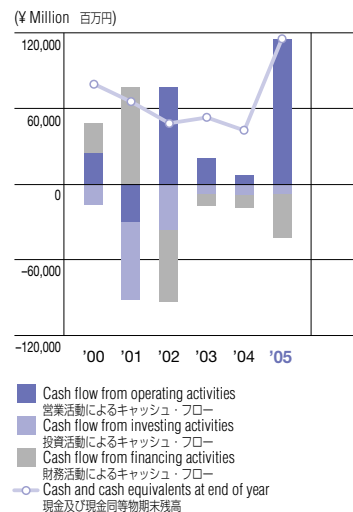


FY 年度	ROA (%) 総資産利益率
2000	7.9
2001	19.8
2002	(2.8)
2003	0.2
2004	4.1
2005	10.7

ROA = (Operating income + Interest and dividend income) / Average total assets × 100
総資産利益率 = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 期首・期末平均総資産 × 100 (%)

Cash Flows

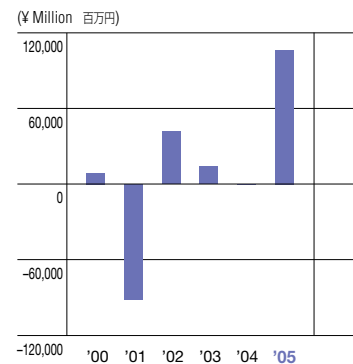
キャッシュ・フロー



FY 年度	Cash flow from activities (百万円)				Cash and cash equivalents at end of year (百万円)
	operating activities 営業活動による キャッシュ・フロー	investing activities 投資活動による キャッシュ・フロー	financing activities 財務活動による キャッシュ・フロー	Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高	
2000	25,127	(16,192)	23,570	79,519	
2001	(29,442)	(62,359)	77,182	65,291	
2002	77,558	(35,789)	(57,214)	48,409	
2003	21,394	(7,270)	(9,884)	52,982	
2004	7,883	(8,544)	(10,271)	42,650	
2005	114,350	(7,450)	(34,344)	115,420	

Free Cash Flows

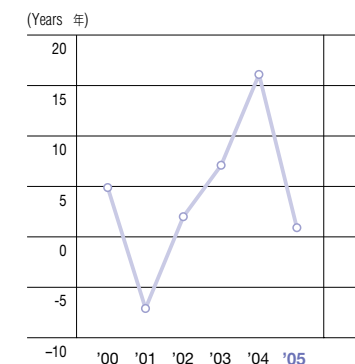
フリー・キャッシュ・フロー



Free cash flow = Cash flow from operating activities + Cash flow from investing activities
フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

Redemption of Debt

債務償還年数



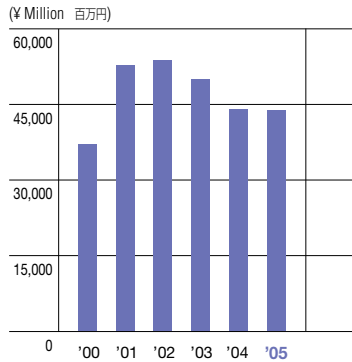
FY 年度	Redemption of Debt (Years)
2000	4.9
2001	(7.1)
2002	2.0
2003	7.1
2004	16.1
2005	0.9

Redemption of debt = Interest-bearing debt / Cash flow from operating activities
債務償還年数 = 有利子負債 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー

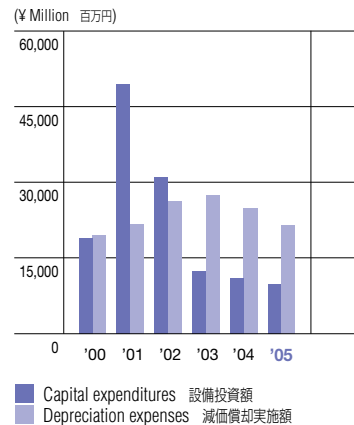
Note: From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

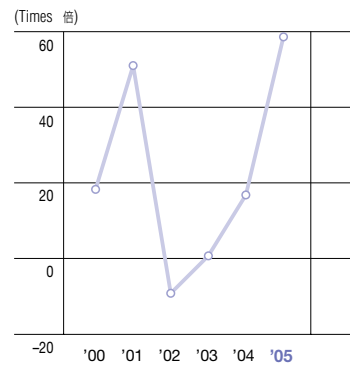
R&D Expenses 研究開発費



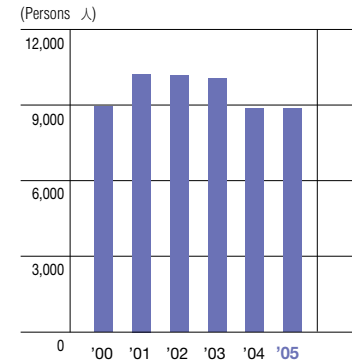
Capital Expenditures and Depreciation Expenses 設備投資額及び減価償却実施額



Interest Coverage Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ

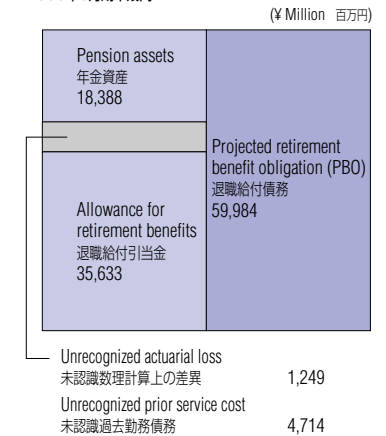


Number of Employees Worldwide 従業員数



Projected Retirement Benefit Obligation and Pension Assets 退職給付債務及び年金資産

Balance at the end of FY2005
2005年3月期末残高



FY	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Capital expenditures (設備投資額)	18,999	49,403	30,946	12,359	11,007	9,876
Depreciation expenses (減価償却実施額)	19,446	21,679	26,294	27,374	24,963	21,463

FY	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Interest coverage ratio (インタレスト・カバレッジ・レシオ)	18.4	51.2	(9.2)	0.8	16.9	58.7

FY	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Number of employees (従業員数)	8,946	10,236	10,171	10,053	8,870	8,864

FY	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Interest coverage ratio (インタレスト・カバレッジ・レシオ)	18.4	51.2	(9.2)	0.8	16.9	58.7

Interest coverage ratio = (Operating income + Interest and dividend income) / Interest expenses
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息 (倍)

Basis of calculation for retirement benefit obligation, etc.

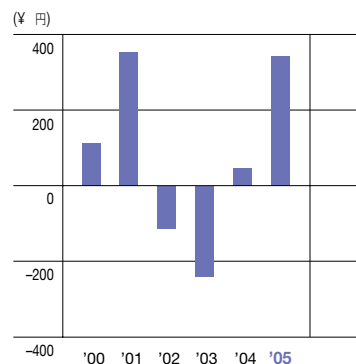
Discount rate	2.0%
Expected rate of return on pension assets	1.5%
Amortized period of actuarial difference	4 years
Amortized period of prior service cost	4 years

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

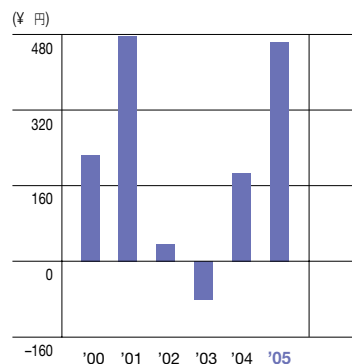
割引率	2.0%
期待運用収益率	1.5%
数理計算上の差異の処理年数	4年
過去勤務債務の額の処理年数	4年

In FY2005, TEL returned a substitutional portion of the employees' pension fund to the Government. As a result, TEL posted an extraordinary gain of 7,083 million yen. 2005年3月期、厚生年金基金の代行部分の過去分の返上を行いました。これにより、特別利益7,083百万円を計上しました。

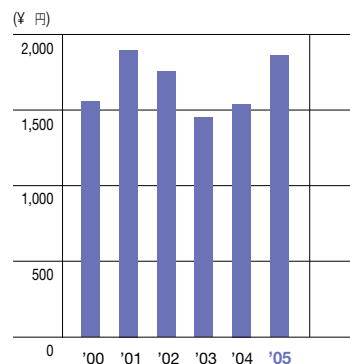
Net Income (Loss) per Share 1株当り当期利益(損失)



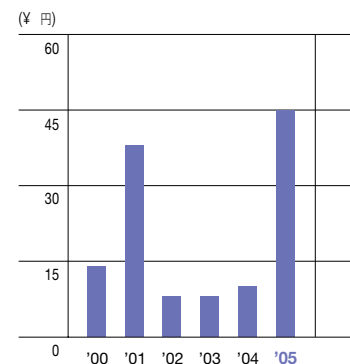
Cash Flow per Share 1株当りキャッシュ・フロー



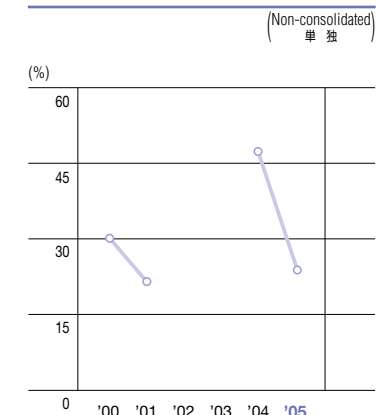
Shareholders' Equity per Share 1株当り株主資本



Cash Dividends per Share 1株当り配当金



Payout Ratio 配当性向



FY 年度	(¥ 円)
2000	113.53
2001	353.76
2002	(113.85)
2003	(238.57)
2004	46.37
2005	343.63

Net income (loss) per share = Net income (loss) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
1株当り当期利益(損失) = 当期利益(損失) / 期中平均発行済株式総数

FY 年度	(¥ 円)
2000	224.75
2001	477.43
2002	36.30
2003	(81.39)
2004	188.31
2005	465.99

Cash flow per share = (Net income + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
1株当りキャッシュ・フロー = (当期利益 + 減価償却費) / 期中平均発行済株式総数

FY 年度	(¥ 円)
2000	1,560.27
2001	1,901.38
2002	1,756.73
2003	1,456.23
2004	1,543.73
2005	1,863.28

Shareholders' equity per share = Shareholders' equity / Total number of shares issued
1株当り株主資本 = 期末株主資本 ÷ 期末発行済株式総数

FY 年度	(¥ 円)
2000	14.00
2001	38.00
2002	8.00
2003	8.00
2004	10.00
2005	45.00

FY 年度	(%)
2000	30.2
2001	21.6
2002	—
2003	—
2004	47.4
2005	23.9

Payout ratio = Cash dividends per share / Non-consolidated Net income per share × 100
配当性向 = 1株当り配当金額 ÷ 単独1株当り当期純利益 × 100 (%)

Notes: 1. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data from FY2001.
2. The payout ratios of FY2002 and FY2003 are not indicated due to net loss on a non-consolidated basis.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 1. 2001年3月期より、1株当り指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。
2. 2002年3月期及び2003年3月期の配当性向は、単独ベースで当期純損失を計上したため掲載しておりません。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ASSETS 資産の部											
Current assets 流動資産											
Cash and cash equivalents 現金及び預金	81,687	49,336	31,016	71,057	46,910	79,519	65,320	48,409	52,982	42,650	115,420
Marketable securities 有価証券	1,010	985	978	835	835	835	—	10	—	—	—
Trade notes and accounts receivable 受取手形・売掛金	118,434	191,242	180,648	192,005	140,746	175,153	302,953	167,982	182,218	245,554	172,488
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(1,140)	(1,810)	(1,692)	(1,822)	(1,134)	(1,029)	(1,720)	(620)	(342)	(155)	(114)
Inventories たな卸資産	47,247	74,587	76,335	100,372	88,085	112,481	161,981	127,352	111,810	105,187	161,489
Deferred income taxes 繰延税金資産	—	—	—	—	—	5,306	12,659	3,402	4,152	2,943	18,173
Prepaid expenses and other current assets 前払費用及びその他の流動資産	4,621	4,260	4,901	10,636	15,306	2,892	7,048	6,888	5,619	6,795	27,730
Total current assets 流動資産合計	251,859	318,600	292,186	373,083	290,748	375,157	548,241	353,423	356,439	402,974	495,186
Investments and other assets 投資その他の資産											
Investment securities 投資有価証券	9,719	8,685	8,902	8,020	8,633	9,010	11,599	9,535	7,216	10,874	10,381
Deferred income taxes 繰延税金資産	—	—	—	—	—	2,145	7,394	22,591	9,362	10,203	15,313
Intangible and other assets 無形固定資産及びその他の資産	11,396	14,651	19,863	25,598	23,430	14,367	37,556	36,855	32,273	28,792	25,024
Total investments and other assets 投資その他の資産合計	21,115	23,336	28,765	33,618	32,063	25,522	56,549	68,981	48,851	49,869	50,718
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	100	—	—	—	—	1,094	—	—	—	—	—
Property, plant and equipment 有形固定資産											
Land 土地	8,839	10,135	10,306	13,678	17,163	16,554	19,698	19,908	19,718	19,577	18,351
Buildings 建物及び構築物	41,541	48,666	56,949	73,847	81,527	89,795	106,753	114,586	110,950	108,718	111,119
Machinery and equipment 機械装置・運搬具及び工具器具備品	27,524	29,790	38,555	46,967	62,777	67,520	84,607	95,615	97,937	92,379	90,497
Construction in progress 建設仮勘定	206	3,955	2,504	4,181	97	877	853	5,139	2,480	2,552	1,786
Total property, plant and equipment 有形固定資産合計	78,110	92,546	108,314	138,673	161,564	174,746	211,911	235,248	231,085	223,226	221,753
Accumulated depreciation 減価償却累計額	(32,909)	(34,432)	(42,188)	(51,774)	(69,472)	(77,020)	(87,190)	(100,737)	(111,474)	(114,437)	123,337
Net property, plant and equipment 有形固定資産合計	45,201	58,114	66,126	86,899	92,092	97,726	124,721	134,511	119,611	108,789	98,416
Total assets 資産合計	318,275	400,050	387,077	493,600	414,903	499,499	729,511	556,915	524,901	561,632	644,320

Notes: 1. Certain items of financial statements were reclassified for FY1997. Accordingly, prior data has been restated to conform with the new presentation.
 2. Tax-effect accounting is adopted from FY2000.
 3. Non-trade accounts receivable until FY2004 is included in the trade notes and accounts receivable.
 4. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
 (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 1. 1997年より勘定科目の区分を一部変更しています。これに合わせてそれ以前のデータも組み換えを行っています。
 2. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
 3. 2004年3月期までの未収金は、受取手形・売掛金に含めています。
 4. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

	(¥ Million 百万円)										
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Liabilities and Shareholders' Equity 負債及び資本の部											
Current liabilities 流動負債											
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	3,866	19,393	12,066	56,917	21,657	23,998	78,462	23,924	43,729	6,815	976
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	39,685	9,000	17,919	9,358	1,536	32,699	2,970	26,387	37,404	21,754	35,476
Trade notes and accounts payable 輸入支払手形及び買掛金・未払金	36,963	58,187	46,049	48,734	36,235	62,574	87,350	41,053	48,279	78,009	70,472
Customer advances 前受金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,970
Income taxes payable 未払法人税等	11,010	27,554	15,514	18,818	1,488	11,843	41,440	1,663	3,645	3,273	13,357
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	4,285	4,781	5,410	6,507	4,117	7,375	10,948	2,463	3,629	6,376	8,645
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,106
Accrued expenses and other current liabilities 未払費用及びその他の流動負債	3,773	4,596	4,074	4,381	4,022	7,969	17,271	14,012	24,020	25,245	21,609
Total current liabilities 流動負債合計	99,582	123,511	101,032	144,715	69,055	146,458	238,441	109,502	160,706	141,472	206,611
Long-term debt, less current portion 長期借入金及び社債	58,596	87,834	70,592	77,657	77,709	67,278	126,348	105,452	70,230	98,476	63,000
Accrued pension and severance costs 退職給付引当金	5,972	7,075	7,028	8,362	9,344	11,581	29,807	32,984	36,392	38,275	36,382
Other liabilities その他の固定負債	858	423	105	141	777	545	1,576	1,340	1,074	3,662	1,751
Total liabilities 負債合計	165,008	218,843	178,757	230,875	156,885	225,862	396,172	249,278	268,402	281,885	307,744
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	—	365	844	1,716	276	—	—	—	—	—	—
Minority interest 少数株主持分	—	—	—	—	26	34	58	58	3,595	3,947	4,411
Shareholders' equity 資本											
Common stock 資本金	29,867	29,922	30,755	45,445	45,532	47,163	47,213	47,214	47,223	54,961	54,961
Capital surplus 資本剰余金	52,937	52,991	53,823	68,507	68,594	70,225	70,275	70,276	70,285	78,023	78,023
Legal reserve 利益準備金	3,000	3,300	3,739	4,228	—	—	—	—	—	—	—
Retained earnings 利益剰余金	67,468	94,640	119,175	142,854	144,715	157,876	214,920	190,195	147,465	154,343	212,094
Unrealized gains on securities 其他有価証券評価差額金	—	—	—	—	—	—	1,658	1,171	(59)	2,396	2,133
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	—	—	—	—	—	—	2,734	3,738	1,229	(720)	997
Treasury stock at cost 自己株式	(5)	(11)	(16)	(25)	(1,125)	(1,661)	(3,519)	(5,015)	(13,239)	(13,203)	(16,043)
Total shareholders' equity 資本合計	153,267	180,842	207,476	261,009	257,716	273,603	333,281	307,579	252,904	275,800	332,165
Total liabilities and shareholders' equity 負債及び資本合計	318,275	400,050	387,077	493,600	414,903	499,499	729,511	556,915	524,901	561,632	644,320

Notes: 1. The Company introduced new retirement benefit accounting from FY2001.
 2. Customer advances until FY2004 are included in other current liabilities.
 3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 1. 2001年3月期から退職給付に係る新しい会計基準を適用しています。
 2. 2004年3月期までの前受金は、その他の流動負債に含めています。
 3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Net sales 売上高	251,683	401,775	432,785	455,585	313,820	440,729	723,880	417,825	460,580	529,654	635,710
Cost of sales 売上原価	178,923	270,125	297,546	304,825	225,962	303,839	458,902	302,270	326,540	389,499	459,797
Gross profit 売上総利益	72,760	131,650	135,239	150,760	87,858	136,890	264,978	115,555	134,040	140,155	175,913
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	51,186	71,471	81,114	94,237	81,475	101,074	143,892	133,865	132,921	117,875	111,930
Portion of enterprise taxes included in selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費に含まれる事業税	2,851	7,575	6,264	6,773	—	—	—	—	—	—	—
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	21,574	60,179	54,124	56,522	6,383	35,816	121,086	(18,310)	1,119	22,280	63,983
Other income (expenses) その他収益 (費用)	(1,777)	(2,656)	98	(462)	(345)	(6,127)	(21,954)	(4,609)	(24,129)	(7,344)	(8,208)
Interest and dividend income 受取利息及び受取配当金	2,436	1,053	909	1,664	898	276	669	351	191	200	236
Interest expenses 支払利息	(2,045)	(1,711)	(1,870)	(1,640)	(2,003)	(1,960)	(2,378)	(1,960)	(1,601)	(1,326)	(1,094)
Other, net その他の収支	(2,168)	(1,998)	1,059	(486)	760	(4,443)	(20,245)	(3,000)	(22,719)	(6,218)	(7,350)
Income (loss) before income taxes 税引前当期利益 (損失)	19,797	57,523	54,222	56,060	6,038	29,689	99,132	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775
Income taxes 法人税等											
Current 法人税・住民税及び事業税	10,310	26,873	24,247	26,051	4,167	14,545	50,589	2,612	4,806	5,108	15,540
Deferred 法人税等調整額	—	—	—	—	—	(4,709)	(13,490)	(5,602)	13,726	1,016	(21,970)
Equity in income (loss) of affiliates 持分法による投資損益	194	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foreign currency translation adjustment and other 為替換算調整勘定等	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Minority interests 少数株主利益	—	—	—	—	5	5	21	8	12	515	604
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	9,731	30,964	29,975	30,009	1,866	19,848	62,012	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601

Notes: 1. Certain items of financial statements were reclassified for FY1997. Accordingly, prior data has been restated to conform with the new presentation.
2. Enterprise taxes, which were included in selling, general and administrative expenses until FY1998, are included in provision for income taxes from FY1999.
3. Tax-effect accounting is adopted from FY2000.
4. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
5. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

注) 1. 1997年3月期より勘定科目の区分を一部変更しています。これに合わせてそれ以前のデータも組み換えを行っています。
2. 事業税について、1998年3月期までは販売費及び一般管理費に含めて表示していましたが、会計基準の変更に伴い、1999年3月期より法人税等に含めて表示しています。
3. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
4. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費の中に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関する費用を売上原価に変更しました。
5. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

	(¥ Million 百万円)					
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Cash flows from operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー						
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)	29,689	99,132	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775
Depreciation and amortization 減価償却費	19,446	21,679	26,294	27,374	24,963	21,463
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額	(31,675)	(121,669)	131,251	(13,662)	(61,789)	59,115
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額	(27,196)	(53,666)	28,359	(3,890)	(5,326)	(59,914)
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額	22,416	9,709	(34,166)	10,352	29,154	(7,440)
Income taxes paid 法人税の支払額	(3,757)	(19,596)	(43,848)	(527)	(6,961)	(4,774)
Other その他	16,204	34,969	(7,413)	24,757	12,906	50,125
Net cash provided by (used in) operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	25,127	(29,442)	77,558	21,394	7,883	114,350
Cash flows from investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー						
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	(14,577)	(39,155)	(31,006)	(7,028)	(7,530)	(8,680)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出	(4,100)	(4,568)	(5,390)	(2,780)	(3,200)	(1,780)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出	—	(18,867)	—	—	—	—
Other その他	2,485	231	607	2,538	2,186	3,010
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	(16,192)	(62,359)	(35,789)	(7,270)	(8,544)	(7,450)
Cash flows from financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー						
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額	26,144	83,779	(51,682)	(4,012)	(8,624)	(27,618)
Dividends paid 配当金の支払額	(2,095)	(4,733)	(4,030)	(1,395)	(1,409)	(3,743)
Other その他	(479)	(1,864)	(1,502)	(4,477)	(238)	(2,983)
Net cash provided by (used in) financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー	23,570	77,182	(57,214)	(9,884)	(10,271)	(34,344)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物に係る換算差額	(468)	391	(1,437)	333	600	214
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額	32,758	(14,228)	(16,881)	4,573	(10,332)	72,770
Cash and cash equivalents at beginning of year 現金及び現金同等物期首残高	46,761	79,519	65,291	48,409	52,982	42,650
Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高	79,519	65,291	48,409	52,982	42,650	115,420

Note: Consolidated statement of cash flows is prepared from FY 2000 in accordance with the format outlined by the revised Securities and Exchange Law.

注) 2000年3月期より、改正後の連結財務諸表規則に基づいた連結キャッシュ・フロー計算書を作成しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2001				2002				2003			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Net sales 売上高	150,812	177,269	182,046	213,752	116,821	136,301	63,738	100,966	92,307	131,081	96,993	140,199
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	127,799	151,559	156,003	183,640	91,924	111,958	44,938	76,895	71,276	105,950	75,392	112,072
FPD Production Equipment FPD製造装置												
Computer Network コンピュータ・ネットワーク	2,330	3,811	3,309	4,605	4,384	4,023	3,304	5,320	3,335	4,792	3,095	5,971
Electronic Components 電子部品	20,325	21,422	22,205	25,259	20,095	19,950	15,184	18,428	17,369	19,990	18,207	21,813
Other その他	360	479	529	247	418	369	312	322	327	349	299	342
Cost of sales 売上原価	94,547	115,664	110,976	137,714	78,575	94,373	46,959	82,364	66,273	88,894	66,915	104,459
Gross profit 売上総利益	56,265	61,605	71,070	76,038	38,247	41,928	16,779	18,602	26,035	42,187	30,078	35,740
Gross profit margin 売上総利益率	37.3%	34.8%	39.0%	35.6%	32.7%	30.8%	26.3%	18.4%	28.2%	32.2%	31.0%	25.5%
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	28,962	33,853	36,700	44,378	37,660	30,581	31,643	33,981	32,176	35,544	31,601	33,600
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	27,304	27,752	34,370	31,660	587	11,346	(14,865)	(15,379)	(6,141)	6,643	(1,523)	2,140
Operating margin 営業利益率	18.1%	15.7%	18.9%	14.8%	0.5%	8.3%	(23.3%)	(15.2%)	(6.7%)	5.1%	(1.6%)	1.5%
Ordinary income (loss) 経常利益 (損失)	26,910	26,957	34,208	31,149	201	10,773	(14,770)	(15,668)	(6,745)	6,043	(1,854)	2,325
Ordinary profit margin 経常利益率	17.8%	15.2%	18.8%	14.6%	0.2%	7.9%	(23.2%)	(15.5%)	(7.3%)	4.6%	(1.9%)	1.7%
Income before income taxes (loss) 税引前当期利益 (損失)	24,989	23,764	32,071	18,307	890	10,858	(14,614)	(20,054)	(6,264)	5,565	(1,921)	(20,390)
Ratio of income before income taxes to net sales 税引前当期利益率	16.6%	13.4%	17.6%	8.6%	0.8%	8.0%	(22.9%)	(19.9%)	(6.8%)	4.2%	(2.0%)	(14.5%)
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	15,241	14,178	19,967	12,626	(3,514)	6,099	(10,681)	(11,843)	(4,172)	1,634	(166)	(38,851)
Net income margin 当期純利益率	10.1%	8.0%	11.0%	5.9%	(3.0%)	4.5%	(16.8%)	(11.7%)	(4.5%)	1.2%	(0.2%)	(27.7%)

Note: Sales of FPD production equipment until FY2004 are included in the sales of semiconductor production equipment.

注) 2004年3月期までのFPD製造装置売上高は、半導体製造装置売上高に含まれています。

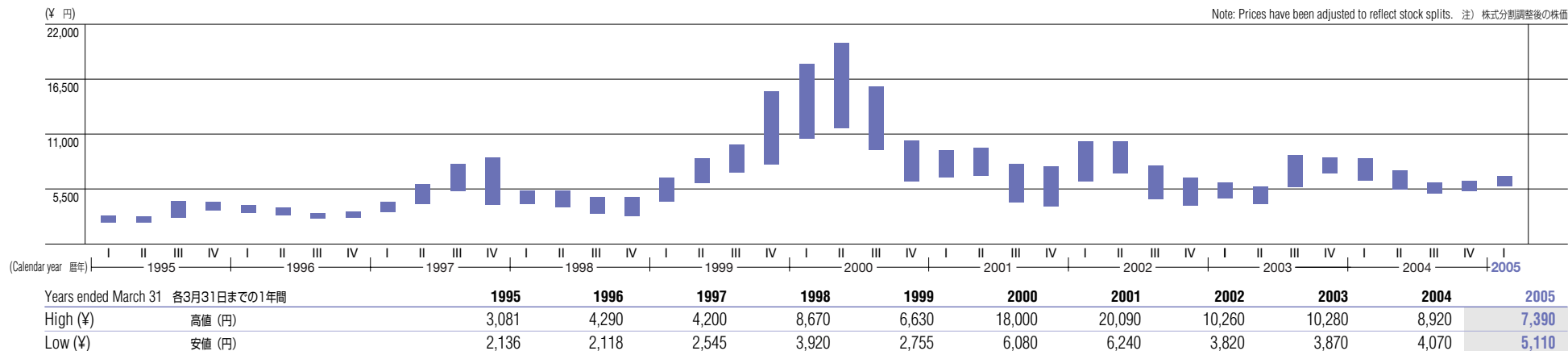
(¥ Million 百万円)

2004				2005				
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	1H	2Q	3Q	4Q
87,779	133,638	121,235	187,002	280,199		149,409	206,102	
65,320	106,913	96,497	157,017	206,064		102,050	149,077	
				21,014		25,266	28,757	
3,398	5,245	3,815	5,990	7,357		3,123	5,486	
18,769	21,142	20,620	23,698	45,137		18,680	22,432	
292	338	303	297	627		289	349	
66,607	98,540	91,462	132,889	203,497		106,991	149,309	
21,171	35,098	29,773	54,113	76,703		42,418	56,793	
24.1%	26.3%	24.6%	28.9%	27.4%		28.4%	27.6%	
29,465	31,598	25,593	31,219	56,427		25,404	30,099	
(8,294)	3,500	4,180	22,894	20,275		17,014	26,694	
(9.4%)	2.6%	3.4%	12.2%	7.2%		11.4%	13.0%	
(8,741)	3,116	4,041	22,752	20,985		17,411	27,238	
(10.0%)	2.3%	3.3%	12.2%	7.5%		11.7%	13.2%	
(9,001)	408	3,808	19,721	7,944		17,355	30,477	
(10.3%)	0.3%	3.1%	10.5%	2.8%		11.6%	14.8%	
(10,366)	560	2,751	15,352	1,273		13,401	46,928	
(11.8%)	0.4%	2.3%	8.2%	0.5%		9.0%	22.8%	

Note: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
2. As changes in accounting policies were made in the second quarter (2Q) of FY2005, aggregate figures for the first quarter (1Q) and the second quarter (2Q) of FY2005 are provided.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
2. 会計方針の変更が2005年3月期の第2四半期に行なわれたため、2005年3月期の第1四半期と第2四半期の数字につきましては合算にて表示しています。

Stock Price Range 株価の推移



Note: Prices have been adjusted to reflect stock splits. 注) 株式分割調整後の株価

PER (Times)	High	株価収益率 (倍)	最高	52.1	22.8	23.1	49.6	619.6	158.5	56.8	—	192.4	21.5
	Low		最低	36.1	11.3	14.0	22.4	257.5	53.6	17.6	—	87.8	14.9
PBR (Times)	High	株価純資産倍率 (倍)	最高	3.3	3.9	3.3	5.8	4.5	11.5	10.6	5.8	7.1	5.8
	Low		最低	2.3	1.9	2.0	2.6	1.9	3.9	3.3	2.2	2.7	2.6
PCFR (Times)	High	株価キャッシュ・フロー倍率 (倍)	最高	32.4	18.3	17.2	34.9	58.4	80.1	42.1	282.6	—	47.4
	Low		最低	22.5	9.0	10.4	15.8	24.3	27.1	13.1	105.2	—	21.6

Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当り当期純利益

Price / book value ratio = Common stock price / Shareholders' equity per share 株価純資産倍率 = 株価 ÷ 1株当り株主資本

Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当りキャッシュ・フロー

Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Number of shares issued (Thousands) 発行済株式数 (千株)	149,674	149,706	150,189	174,569	174,624	175,660	175,691	175,691	175,698	180,611	180,611
Market capitalization (¥ Billion) 時価総額 (十億円)	395.1	546.4	615.8	783.8	1,070.4	2,722.7	1,454.7	1,583.0	815.2	1,255.2	1,103.5

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式終値 × 発行済株式数

Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

Public Offering of Common Stock 有償・公募

Date of issue 発行年月日	Subscribed shares (Thousands) 発行株式数 (千株)	Issuing price (¥) 発行価格 (円)
June 2, 1980	4,131	1,540
July 1, 1981	2,000	4,730
October 16, 1982	4,000	3,050
May 6, 1983	20	2,550
June 23, 1984	3,000	4,015
November 15, 1989	6,000	3,233

Stock Splits 株式分割

Date of issue 発行年月日	Ratio of distribution 分割比率	
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

Equity-Linked Bonds 転換社債・新株引受権付社債

As of March 31, 2005 2005年3月31日現在

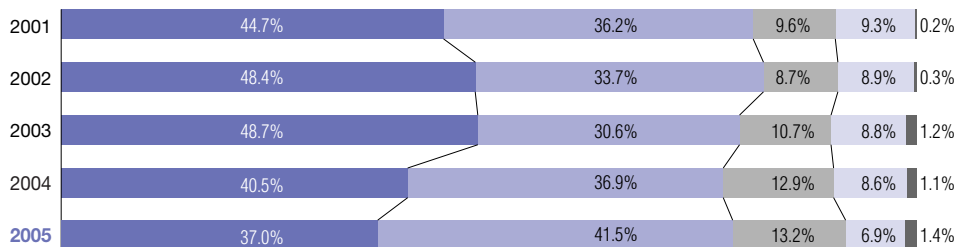
Date of issue 発行年月日	Type 種類	Amount 発行額	Coupon rate 利率	Expiry date 行使期限	Balance 未行使残高	Exercise rate 行使率	Exercise price 行使価格
June 9, 2000 2000年6月9日	#4 unsecured bonds with warrants 第4回無担保新株引受権付社債	¥4.5 billion 45億円	1.59%	June 9, 2006 2006年6月9日	¥4.5 billion 45億円	—%	¥14,070 14,070円
June 8, 2001 2001年6月8日	#5 unsecured bonds with warrants 第5回無担保新株引受権付社債	¥5.5 billion 55億円	0.86%	June 8, 2007 2007年6月8日	¥5.5 billion 55億円	—%	¥ 9,608 9,608円

Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)	Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	20,020	11.08	State Street Bank And Trust Co. ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505103	3,474	1.92
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	12,548	6.94	The Chase Manhattan Bank 385036 ザ チェース マンハッタン バンク 385036	3,384	1.87
Tokyo Broadcasting System, Inc. 株式会社東京放送	10,227	5.66	Nippon Life Insurance Co. 日本生命保険相互会社	3,182	1.76
The Chase Manhattan Bank, N.A. London ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン	9,827	5.44	Barclays Bank PLC Barclays Capital Securities バークレイズバンクピーエルシー バークレイズキャピタルセキュリティーズ	3,065	1.69
Dai-ichi Mutual Life Insurance Co. 第一生命保険相互会社	4,800	2.65	UFJ Bank 株式会社UFJ銀行	3,000	1.66

Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

Category 区分	2001			2002			2003			2004			2005		
	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比		
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社	321	78,534	44.7%	232	85,089	48.4%	227	85,624	48.7%	232	73,221	40.5%	207	66,817	37.0%
Foreign institutions and others 外国法人等	611	63,663	36.2%	589	59,118	33.7%	583	53,687	30.6%	571	66,604	36.9%	553	74,864	41.5%
Japanese individuals and others 個人・その他	41,203	16,833	9.6%	35,776	15,232	8.7%	47,821	18,862	10.7%	59,361	23,251	12.9%	59,415	23,902	13.2%
Other Japanese corporations その他の法人	645	16,253	9.3%	518	15,646	8.9%	627	15,490	8.8%	708	15,513	8.6%	681	12,498	6.9%
Treasury stock 自己株式	1	408	0.2%	1	606	0.3%	1	2,035	1.2%	1	2,022	1.1%	1	2,530	1.4%
Total 合計	42,781	175,691	100.0%	37,116	175,691	100.0%	49,259	175,698	100.0%	60,873	180,611	100.0%	60,857	180,611	100.0%



■ Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社
■ Foreign institutions and others 外国法人等
■ Japanese individuals and others 個人・その他
■ Other Japanese corporations その他の法人
■ Treasury stock 自己株式



TOKYO ELECTRON LIMITED



World Headquarters

TBS Broadcast Center
3-6, Akasaka 5-chome
Minato-ku, Tokyo 107-8481, Japan
Tel: +81-3-5561-7000
Fax: +81-3-5561-7400
URL: <http://www.tel.com>

**Investor Relations
Corporate Communications Dept.**

Tel: +81-3-5561-7003
Fax: +81-3-5561-7400

Printed on 100% recycled paper.
本誌は再生紙を使用しています。

Printed in Japan
43AG-004